

## 2008年3月期 中間期 決算説明会（2007年11月2日実施）

スライドP1～ 代表取締役社長 川村誠スピーチ

代表取締役社長 川村誠スピーチ

### <スライド1：本日のプレゼンテーション>

本日は、こちらのスライドにございますように、当中間期の決算概要と、通期業績予想についてご説明申し上げます。

### <スライド2：将来予想に関する注意事項>

なお、本日の説明内容につきましては、このスライドに記載しております「将来予想に関する注意事項」にご留意願います。

### <スライド3：2008年3月期中間期連結決算概要>

こちらのスライドは、当中間期の連結決算概要です。

先日開催いたしましたカンファレンスコールでの発表内容と、一部重複がございますが、カンファレンスコールをお聞きいただけていない方も多数いらっしゃると思いますので、ご容赦いただきますようお願いいたします。

当中間期の連結売上高は、6,366億円、前年中間期に比べ、3.4%の増収となりました。営業利益および税引前中間純利益は、前年中間期に比べ、それぞれ7.4%、12.6%上回ることができました。

中間純利益は、前年中間期に発生した移転価格課税の更正処分の一部取消しによる還付税額や、京セラリーシングの売却による一時的な利益計上がなかったため、当中間期は前年中間期に比べ、5.4%減益の506億円となりました。

続きまして、その下にあります設備投資額は、前年中間期に比べ、12.5%減少し、326億円でした。これに対し、減価償却費は前年中間期に比べ10.7%増加となる373億円でした。減価償却費の増加の理由については、のちほどご説明いたします。

#### <スライド4：2008年3月期中間期連結決算ハイライト(1)>

それでは、当中間期の連結決算の重要ポイントを4つ、ご説明申し上げます。

まず、当中間期の売上高は、中間期では過去最高となりました。

2つ目は、第2四半期の売上高、営業利益が第1四半期と比べ、増収増益となっている点です。

#### <スライド5：連結決算ハイライト(2)－事業別業績－>

こちらのスライドは、セグメント別の当期第2四半期の業績と、第1四半期との比較です。

まず、部品事業は、需要が順調に拡大したことにより、第2四半期は、第1四半期に比べ、売上高で4.8%、事業利益で8.7%増加し、事業利益率は15.0%と、いずれも第1四半期を上回りました。

次に、機器事業ですが、第1四半期に比べ、売上高は微減となりましたが、事業利益は11.5%増加しました。

PHS事業の利益が改善し、通信機器関連事業は、第1四半期の赤字から、第2四半期には黒字転換しました。

また、情報機器関連事業では、MFP及びプリンタの売上拡大による事業利益の増加が貢献しました。機器事業の第2四半期の事業利益率は、8.2%となり、第1四半期を上回りました。

その他の事業につきましても、京セラコミュニケーションシステム(株)の貢献により、第2四半期は第1四半期に比べ、売上高、事業利益ともに拡大し、事業利益率は7.9%となり、第1四半期を上回りました。

#### <スライド6：連結決算ハイライト(3)>

3点目は、減価償却費が大幅に増加した中でも、当中間期の営業利益が前年中間期に比べ、7.4%増益となったことです。

当中間期には、税制改正を機に、固定資産の価値を総合的に見直したことによる

影響額として、75億円の減価償却費を計上しました。特に、第2四半期には、耐用年数を経過した建物・関連設備について35億円を一括計上しました。

しかしながら、第2四半期も引き続き、生産性向上に努めた結果、第1四半期に比べましても、第2四半期は営業利益増益を達成しております。

#### <スライド7：連結決算ハイライト(4)－四半期別営業利益率の推移－>

こちらのグラフは、2006年3月期以降の、営業利益率の四半期別推移を表しています。

当期第2四半期の営業利益率は、35億円の一括償却費用を含めて11.3%でした。これは、前期、2007年3月期において最も高かった第3四半期に並ぶ水準です。さらに下半期は、デジタルコンシューマ機器市場の需要拡大が持続することに加え、部品事業及び機器事業の両方において収益性改善を図り、12.0%の営業利益率を予想しております。

#### <スライド8：連結決算ハイライト(5)>

続きまして、配当についてご説明申し上げます。

#### <スライド9：連結決算ハイライト(6)－1株当たり配当金の推移>

当中間期の業績及び当社の配当方針を踏まえ、当中間期の配当金につきましては、前年中間期に比べ10円増配の1株当たり60円とさせていただきます。なお、年間の配当金につきましては、従来予想の1株当たり110円を10円増配し、1株当たり120円とさせていただく予定であり、4期連続の増配を予定しています。

#### <スライド10：本日のプレゼンテーション>

続きまして、通期の業績予想についてご説明申し上げます。

#### <スライド11：2008年3月期事業環境見通し>

このスライドは、通期業績予想の前提となる、世界の主要電子機器の生産台数の見通しであります。こちらの見通しについては、期初からの変更はございません。

また、部品単価の動向につきましても、期初見通しどおり、一般電子部品、たとえばセラミックコンデンサの汎用品で、年間で前期末比10%前後の下落にとどまると予想しております。

#### <スライド12：2008年3月期連結業績予想（1）>

このように、事業環境の見通しは順調であり、加えて、第2四半期の収益性は第1四半期に比べ確実に向上しており、下半期も一層の収益向上が図れると考えています。

京セラグループ通期の連結業績予想数値については、期初予想から変更はありませんが、セグメント別業績予想については、各事業の中間期までの業績と、下半期の市場環境や減価償却費の見直しなどを勘案した結果、変更いたしました。具体的な数値につきましては、お手元の資料の20ページ及び21ページに記載しておりますので、後ほどご参照ください。

また、設備投資額の通期見通しは、期初予想の860億円から50億円減額し、810億円としています。研究開発費につきましても、期初予想の670億円から20億円減額し、650億円と変更いたしました。なお、減価償却費については、設備投資が期初予想から減額となるため、期初予想の790億円から変更はいたしておりません。

なお、下半期の平均為替レートの見通しにつきましては、期初の見通しと変更なく、下半期の6ヵ月について、1ドル=110円、1ユーロ=150円としています。

#### <スライド13：2008年3月期連結業績予想（2）>

新しい予想では、部品事業の売上高は、前期比6.8%の増収となる6,950億円、事業利益は、減価償却費の増加の影響などから、3.1%の増益となる1,080億円を予想しております。事業利益率は、15.5%となり、当社グループ全体の目標である15%を上回る予定です。

機器事業では、売上高は、前期比1.5%の減収となるものの、事業利益は、前期比19.7%の増益となる410億円を予想しております。利益率は8.0%となり、前期を上回る予定です。

#### ＜スライド14：2008年3月期事業セグメント別売上高・税引前当期純利益予想－前期比増減額－＞

このスライドは、事業セグメント別の新たな業績予想と、前期実績とを比較したグラフです。

各事業セグメントの売上高及び税引前利益の通期予想と、前期実績とを比較し、その増減金額を示しております。上段が売上高、下段が税引前利益の増減額です。今期の増益を牽引する事業は、ファインセラミック応用品関連事業及び情報機器関連事業でございます。

続きまして、各事業セグメントの下半期以降の取り組みを具体的に説明いたします。

#### ＜スライド15：下半期以降の取組み（1）＞

ファインセラミック部品関連事業では、下半期も、携帯電話需要の世界的拡大が継続することから、携帯電話端末のバックライトに使用するLED用サファイア基板、及び電波のフィルタとして基地局に使用する誘電体セラミック部品の売上を拡大してまいります。

また、継続的な事業拡大を図る取組みとして、既存製品におけるシェア拡大や、ファインセラミックの新市場開拓など、引き続き取組みを進めてまいります。

次に、半導体部品関連事業について申し上げます。

まず、セラミックパッケージですが、この部門のメイン市場であります携帯電話端末の生産拡大が続く見通しであることから、携帯電話端末用パッケージの売上拡大を見込んでおります。具体的には、主力製品である電子部品用表面実装（SMD）パッケージや、CCD／CMOS用パッケージの売上を拡大してまいります。また、携帯電話端末に搭載されるRFモジュールの生産が拡大しており、そこに使用されるLTCC基板についても売上拡大を図ります。

さらに、電子部品用表面実装パッケージ技術による新市場の開拓についても、引き続き進めてまいります。

有機パッケージにつきましては、携帯電話端末市場向けのSiP基板の売上が順

調に拡大しております。ゲーム機向けの有機パッケージの売上も順調です。また、中期的展開としまして、ハイエンドASIC用パッケージを薄型テレビなどのデジタル家電に搭載するなど、アプリケーションを拡大し、さらなる売上拡大を図ってまいります。

なお、有機パッケージ事業は、生産数量の拡大にともない、当期下半期を通じて黒字転換できると考えております。

### <スライド16：下半期以降の取組み（2）>

続きまして、「ファインセラミック応用品関連事業」の中心事業である、ソーラーエネルギー事業について申し上げます。

海外市場の旺盛な需要が継続する中、当社はシリコン原料の調達量を第2四半期以降、徐々に増やすことができいております。下半期は、さらに原料調達量が増加しますことから、ソーラーモジュールの生産量は上半期実績に比べ、25%拡大できる見通しです。

また、国内市場においては、下半期に産業用途の大型案件が増加する見通しです。個人住宅向けの補助金制度が終了したことにより、国内需要が減少しておりますが、補助金制度が継続している産業用途の案件を確実にとらえ、売上の拡大を図ってまいります。

また、中期的な計画として、既にお話していますように、2011年3月期に、500MWの生産量を実現する計画に沿って、引き続き設備投資を進めてまいります。

さらに、長期的に太陽電池メーカーとして競争優位を維持するためには、変換効率の高い太陽電池を供給することが重要な戦略であると考えております。当社は現在、15センチ角の多結晶シリコン太陽電池において、研究レベルで世界最高となる変換効率18.5%を達成しております。電極を裏面に配置することにより太陽電池の受光面積を増やすバックコンタクトや、表面処理により太陽光の反射を抑制し、吸収を高める技術など、今後もさらに新しい技術開発を進め、高効率の太陽電池を開発してまいります。

次に、電子デバイス関連事業について申し上げます。

電子部品は、足元の第3四半期の需要が好調であり、増産対応も寄与して、下半期の売上が拡大します。具体的には、セラミックコンデンサ、水晶振動子、SAWフィルタなど、需要が好調な部品の増産を進めております。

また、中期の事業拡大を図る目的で、デジタル家電、無線アプリケーション、高速半導体周辺などの重点市場を、集中的に攻略してまいります。

さらに、新製品比率のアップや、当社グループの機器部門との連携強化を進めてまいります。

### <スライド17：下半期以降の取組み（3）>

続きまして、「通信機器関連事業」について申し上げます。

まず、携帯電話事業では、国内市場で需要が特に伸びる第4四半期をターゲットに、KDDI様向けにWIN端末の新製品を投入することで、売上拡大を図ってまいります。

KWCにつきましては、クリスマス商戦の第3四半期に出荷数量を伸ばし、売上拡大を図り、下半期の黒字化、最低でもブレークイーブンを目指します。さらにPHS事業では、端末事業の強化を図ります。

最後に、「情報機器関連事業」について申し上げます。

上半期に引き続き、カラープリンタ、MFPなどの新製品投入により、モノクロ機からの買い換え需要を促進させ、売上を拡大してまいります。また、三重県にある既存工場にトナー工場を建設し、カラー消耗品の競争力強化を図ります。海外においては、東欧及びBRICs諸国でモノクロ機の販売を強化します。さらに、欧州物流センターの統合により物流効率の向上を図るとともに、納期短縮など顧客への満足度を向上させ、シェアアップを図ってまいります。

### <スライド18：連結売上高・税引前利益の推移－2004年3月期～2008年3月期（予想）－>

今期の通期業績予想の税引前利益率は、12.5%となります

が、当社の目標は「持続的な売上拡大と高い収益率」の実現です。この実現に向

け、できるだけ早い時期に税引前利益率15%を達成するよう取り組んでまいります。

以上が下半期の取組みと、今期の業績予想の内容です。

それでは、私の説明の最後に、先日公表いたしました、三洋電機様の携帯通信事業の譲り受けの基本合意に関連して、簡単にご報告申し上げます。

### <スライド19：通信機器関連事業の強化>

現在、デューデリを行っているところであり、現時点で申し上げられることは非常に限定されておりますことを予めご了承くださいと思います。

通信機器関連事業は、当社グループのコア事業のひとつであり、さらなる強化が必要であります。

通信機器関連事業における当社の目標は、高収益な無線通信機器事業の確立です。この目標に向けての具体的な課題としては、まず、現在低い採算にとどまっている海外市場での通信機器事業の強化があります。そして、もうひとつは、国内市場において、確固たる地位を確立するための競争力強化があります。

この目標を達成するために、三洋電機様の優れた開発力や設計技術、海外市場を含めた幅広い客先層を経営資源と融合することにより、一層の原価低減が図れるものと考えています。

このたびの、三洋電機様からの事業の譲り受けについての基本合意につきましては、このように経営資源の強化やコスト削減に貢献するものと期待をもって取り組んでいるものです。

後日、進展がございましたら、あらためてご報告させていただきたいと思います。以上で私からの説明を終了させていただきます。今後とも皆様のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

以 上